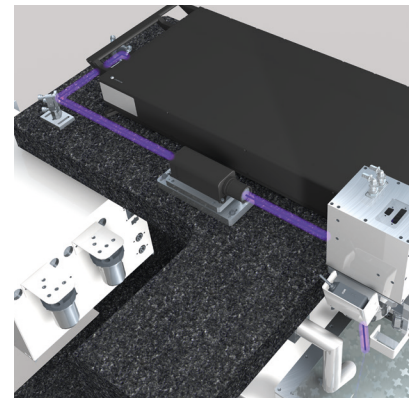
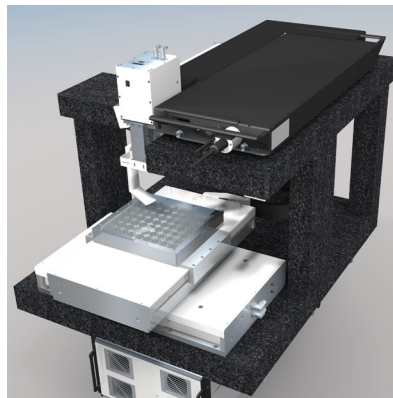


POLYPHOS DP 8000 Serie



Beschreibung

Die POLYPHOS DP 8000 Serie ist eine Maschinenplattform für das Nutzentrennen von starren und flexiblen Leiterplatten. Eine Basis aus Granit sorgt für ein Maximum an Stabilität und Präzision.

Es sind unterschiedliche Strahlquellen verfügbar, um den Laserschneidprozess an das Material anzupassen.

Die Anlage ist als manuell zu beladendes System oder vollautomatisches Inline-System erhältlich. Für die Inline-Produktion sind mehrere produktspezifische Warenträger-Trägertransportsysteme verfügbar.

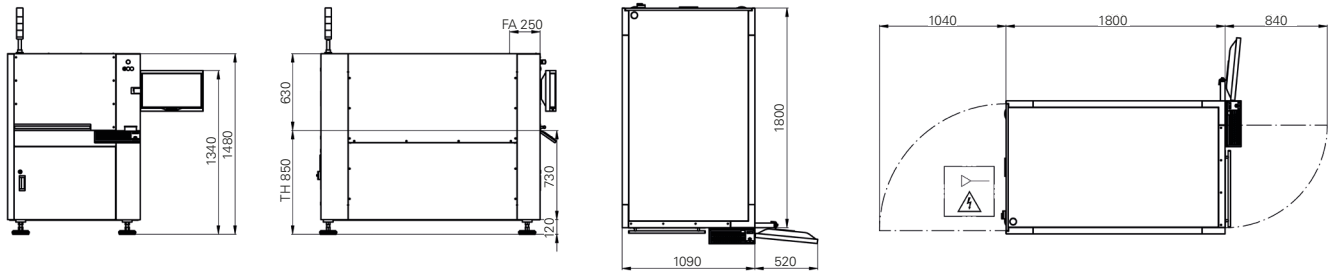
Eine Kamera wird zur Maschinenkalibrierung und Offset Korrektur mithilfe von Fiducials eingesetzt. Die Anlage beinhaltet ein präzises xy-Achs-System und einen digital geregelten Galvo Scanner, um einen Step&Scan Prozess und dadurch einen optimierten Durchsatz und Genauigkeit zu ermöglichen.

Eigenschaften

- _ Staub- und stressfreies Trennen von starren und flexiblen Leiterplatten
- _ Hohe Positioniergenauigkeit
- _ DIN-sprachenkontrollierte (CNC) Schneidrezepte
- _ Integriertes Kamerasystem
- _ Strahlquellen und Optiken für verbesserte Schneid-ergebnisse sind auf dem letzten Stand der Technik

Optionen

- _ UV Laser für flexibles und dünnes FR4 Material
- _ 30 W Green Laser für das Schneiden von FPCBA und FR4
- _ 40 W Green Laser für höheren Durchsatz
- _ CO₂-Laser für das Schneiden von Polyimiden und für Nischenanwendungen
- _ Fokusverschiebung für dicke LPs und zum Ausgleich von verschiedenen Werkstückträgerhöhen
- _ Laserleistungsmessung
- _ Laserleistungskalibrierung
- _ ASYCAM Software für ein einfaches Importieren von CAD (DXF) Daten
- _ Absaug- und Filtersystem
- _ Externer Luft-Wasser-Rückkühler für CO₂ und UV-Laser
- _ MES-Anbindung
- _ Inline Transport auf Warenträgern
- _ Warenträger-Rücktransport-System



POLYPHOS DP 8000 Serie

	POLYPHOS DP 8000	POLYPHOS DP 8100	POLYPHOS DP 8200
Maschinenkonfiguration			
Transporthöhe	950mm ±50mm		
Bedienseite	Vorne		
Arbeitsbereich	305 x 250mm	460 x 305mm	460 x 460mm
Scanfeld	50 x 50mm bis zu 80 x 80mm (abhängig von Wellenlänge)		
Leiterplattenformat			
LP-Länge	20 bis 305mm	20 bis 460mm	20 bis 460mm
LP-Breite	20 bis 250mm	20 bis 305mm	20 bis 460mm
LP-Dicke	Empfohlen: 0,1 bis 1,6mm (2,0mm)		
Max. Leiterplattengewicht (Nutzen)	4kg		
Max. Leiterplattengewicht (LP)	1,5kg		
Freie Durchfahrtshöhe	+40mm / 0mm bei manuellem Laden (weitere Optionen auf Anfrage)		
Installationsanforderungen			
Elektrischer Anschluss	3/N/PE AC 400/230V 50Hz 3/N/PE AC 208/120V 60 Hz		
Leistungsaufnahme	UV-Laser Ø 5,6kW, max. 7,2kW GN-Laser Ø 2,7kW		
CDA Anschluss	6bar		
CDA Verbrauch	20NI/min		
Wasserkühlung	10l/min, 15°C, 2,0kW UV-Laser 7,5l/min, 18...20°C, 1,7kW 100W CO2-Laser GN-Laser Option beinhaltet AW-Rückkühler	3l/min, 20°C 500W 30W GN Laser 600W 40W GN Laser	3l/min, 20°C 500W 30W GN Laser 600W 40W GN Laser
Umgebungstemperatur	22°C ±1°C		
Luftfeuchtigkeit	50% ±20% (n. kond.)		
Maschinenbeschreibung			
Länge x Breite x Höhe	1090 x 1800 x 1455mm	1400 x 1800 x 1570mm	1400 x 1900 x 1570mm
Freiraum für Wartung auf Rückseite	1040mm	670mm	670mm
Lasertyp	UV 343nm GN 532nm CO2 9300nm (weitere auf Anfrage)		
Laserkategorie	1		
Positioniergenauigkeit	±15µm @ 5σ		
Wiederholgenauigkeit	±5µm @ 5σ		
Trenn-Genauigkeit	±25µm mit Vision System @ 5σ		
Fiducial-Kamera	25 x 18mm FoV		
Gewicht	ca. 1725kg	2200kg	2200kg
Farbe	Basic Light, RAL 7015, RAL 4010		
Geräuschpegel	< 75dB(A)		

**ASYS
GROUP**

ASYS Automatisierungssysteme GmbH
Benzstrasse 10
89160 Dornstadt, Germany
Tel (+49) 7348 9855 0
Fax (+49) 7348 9855 91
info@asys-group.com

Für mehr Informationen besuchen Sie
www.asys-group.com

Änderungen vorbehalten.
Alle aufgeführten Informationen sind allgemeine Beschreibungen und Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in dargestellter Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Verbindlich sind lediglich die im Vertrag vereinbarten Leistungsbeschreibungen.

Printed in Germany